



ICAC
2021

2021 第三届华人芯片设计技术研讨会
WORKSHOP ON IC ADVANCES IN CHINA

May 20 - 21, 2021 | Shenzhen, China 2021年5月20-21日 | 中国·深圳



2021 第三届华人 芯片设计技术研讨会

2021年5月20日-21日

深圳福田香格里拉大酒店

▶ 主办单位

澳门大学, 清华大学, 电子科技大学

▶ 联办及支持单位

珠海澳大科技研究院, 深圳市福田区人民政府,
河套深港科技创新合作区领导工作小组办公室

▶ 会议规模

约600人

芯片已经成为我们日常生活的一部分, 不仅如此, 它对国家的重要性也在日渐上升。芯片广泛运用于各种电子产品和系统, 是高端制造业的核心基石。华人芯片设计技术研讨会 (ICAC) 致力于为中国集成电路设计的学术界和产业界同仁建立一个顶尖的技术交流平台, 会议只邀请过去两年中在集成电路设计领域顶级期刊 (ISSCC 或 JSSC) 发表过优秀论文的中国顶尖 IC 设计学者 / 工程师做学术报告, 营造开放的技术讨论氛围, 集思广益, 共同提高。此次大会聚焦当下热门行业问题, 解答企业发展问题, 提出新观点, 发展新方向, 拓展新视野。





本届会议为期 2 天，共邀请了 39 位中国集成电路设计的学术界和产业界的顶级专家学者作专题报告。深圳市福田区人民政府副区长欧阳绘宇在大会上致辞，他指出集成电路与微电子是合作区发展的重要方向，本届大会集聚芯片领域前沿高端资源，共话集成电路产业未来发展，对于推动电子信息产业产学研合作发展有着重要意义。清华大学集成电路学院，大会荣誉主席王志华教授在开幕致辞中切身实际地谈到了自己的治学之路和大陆集成电路设计业的发展历程，并鼓励青年学者做到“世界先进”甚至是“世界领先”。精英论道，结鸿鹄之交，会议期间精彩纷呈的报告及问答互动是一次观点的碰撞，更是一场思想的盛宴。学术界和工业界的精英互相交流，不仅有助于学术产业化，与工业需求相结合；在学术交流的同时，了解当下的工业需求，解决企业问题，带来更多新视野和新方向，为提升中国集成电路行业水平，助力中国芯片产业达到新高度尽绵薄之力。



从首届会议开始，亚昂全程深度负责了会议从学术到会议组织的各方面工作，从 18 年的正常线下会议到如今疫情常态化情况下线上线下结合的会议模式，在办会环境不断变化的过程中提供新的解决方案，确保每年会议顺利举行，不断扩大会议的影响力及会议品牌效应。